

【事業戦略】

<半導体事業>

- ① プロセスイノベーションで顧客ニーズに応える
- ② DXとAIの活用で世界のコストリーダーへ
- ③ グローバルな開発体制でオンリーワン製品を世界に

<メディカルデバイス事業※>

- ① すぐれた成形技術を高度な医療機器づくりに
- ② 一貫生産で高収益体制に
- ③ 技能の研鑽で価値創造ビジネスを

※「化成品（ファインプラスチック成形品）事業」の名称を「メディカルデバイス事業」に変更いたします。

<新事業>

- ① コアコンピタンスを軸に高付加価値製品で事業拡大を
- ② 工具メーカーとしてメジャーブランドに
- ③ サブスクビジネスで新たな収益を築く
- ④ リニューアルビジネスでサステナビリティを実現

<レーザ事業>

- ① 競争力のある製品で安定的な収益確保と事業拡大を
- ② 発振ユニット内製化とサブスクビジネスへ
- ③ レーザ技術で半導体プロセスに一石を

【人財戦略】

- ① 企業理念の継承と技術の伝承を TOWA アカデミーで
- ② 未来を担うリーダーの創出
- ③ DX・AIで人的資本の強化
- ④ 多様な人財の活躍環境の構築

【財務戦略】

新たに財務 KPI と株主還元目標を設定（2028 年 3 月期までの目標）

- ① 財務 KPI：ROE 13%以上
- ② 株主還元：配当性向 20%以上

3. 経営指標（連結）

（単位：億円）

期別		2025年3月期 予想	→	2028年3月期
項目				
売上高		540.0	+31.5%	710.0
売上高 内訳	半導体製造装置事業	399.0	+30.6%	521.0
	医療デバイス事業	22.8	+22.8%	28.0
	新事業	95.6	+39.1%	133.0
	レーザー加工装置事業	22.6	+23.9%	28.0
営業利益		92.0	+69.6%	156.0
営業利益率		17.0%	+5.0pt	22.0%
経常利益		97.6	+59.8%	156.0
親会社株主に帰属する 当期純利益		78.7	+38.5%	109.0

※本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。

以上

第二次中期経営計画

2026年3月期～2028年3月期



TOWA This material is the property of TOWA CORPORATION

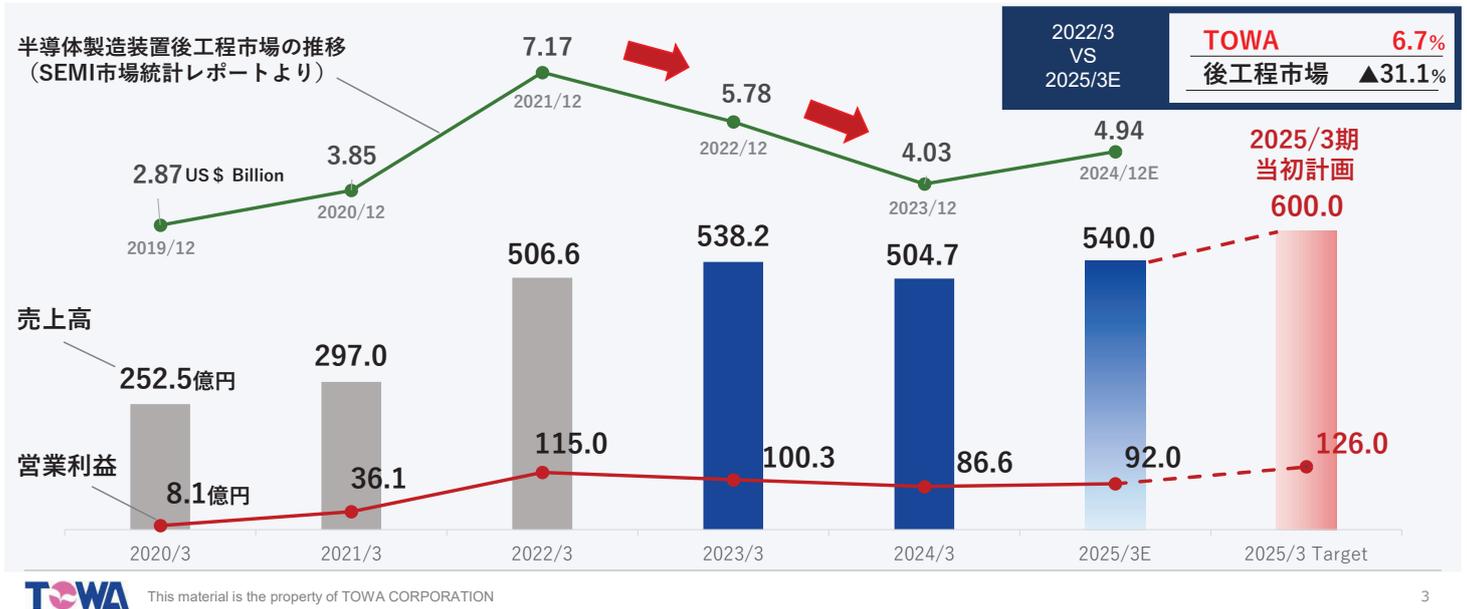
主な説明内容

1. 第一次中期経営計画の振り返り
2. 第二次中期経営計画

TOWA This material is the property of TOWA CORPORATION

第一次中期経営計画の振り返り（数値目標）

数値目標は当初計画に対して未達であったものの、市場の落ち込み時でも500億円以上の売上を安定して達成出来る基盤を構築。



3

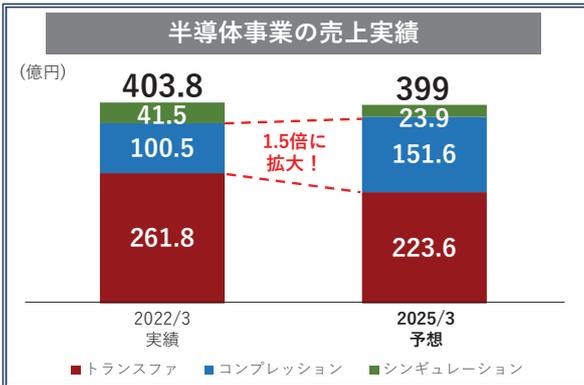
第一次中期経営計画の振り返り（数値目標）

	2022年3月期 実績	→	2025年3月期 見通し	
売上高	売上計	506.6億円	+6.6%	540.0億円
	半導体	403.8億円	▲1.2%	399.0億円
	化成品	17.2億円	+32.6%	22.8億円
	新事業	63.3億円	+51.0%	95.6億円
	レーザ	22.2億円	+1.8%	22.6億円
営業利益	115.0億円	▲20.0%	92.0億円	
営業利益率	22.7%	▲5.7pt	17.0%	

4

第一次中期経営計画の振り返り（半導体事業）

- ✓ TOWA独自のコンプレッションモールディング装置・金型を拡販
- ✓ 次期中計の柱となる市場競争力のある製品を開発
- ✓ トップシェアの維持とシェアをさらに拡大



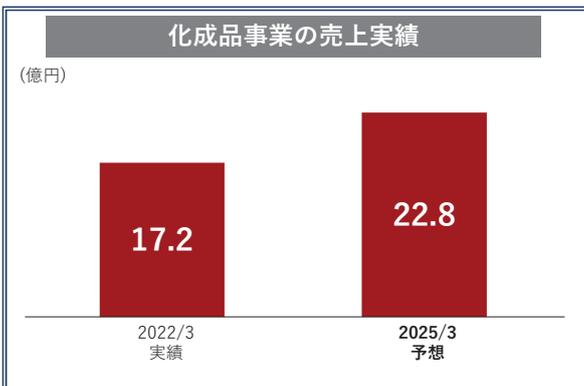
主な成果

- ・ 生成AI向けなどの先端パッケージに独自プロセスのコンプレッション装置が採用され、売上が増加。コンプレッションの売上規模は1.5倍へ拡大。
- ・ チップレットに最適な装置「YPM1250-EPQ」を開発し、半導体オプ・ザ・イヤーズ2024 製造装置部門でグランプリを受賞。
- ・ 半導体モールディング装置の世界シェアを59%から63%※へ拡大。引き続き、トップシェアを維持。
- ・ マレーシアで金型製造事業を譲受し同地域における金型・装置一貫生産体制を構築。また、今後需要の増加が期待されるインドへも進出。

※ Source : TechInsights Inc社データを基に当社作成（推定値）

第一次中期経営計画の振り返り（化成品事業）

- ✓ クリーンルームを活用し、高付加価値製品の取扱いを拡大
- ✓ 事業拡大に向け、生産エリアを増設

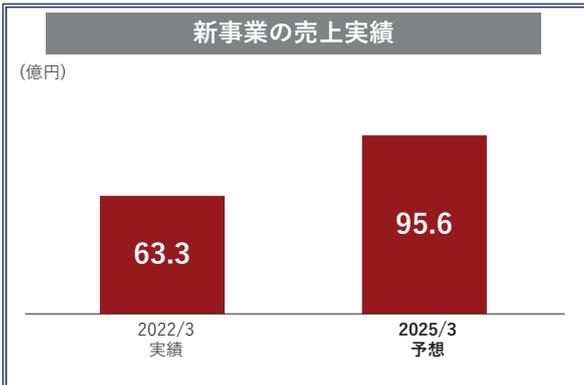


主な成果

- ・ 医療機器組立技術を活用し新規顧客を開拓
- ・ クリーンルームを活用し、技術力と競争力をさらに強化
- ・ 人材及び設備増強により生産能力30%増

第一次中期経営計画の振り返り（新事業）

- ✓ 累計装置納入台数の増加に加え、メーカー直結の付加価値の高いアフターサービスにより、TSS※の売上が増加
- ✓ リリースフィルムやブレードなどの半導体関連の消耗品を拡販
- ✓ 工具事業の海外展開を開始



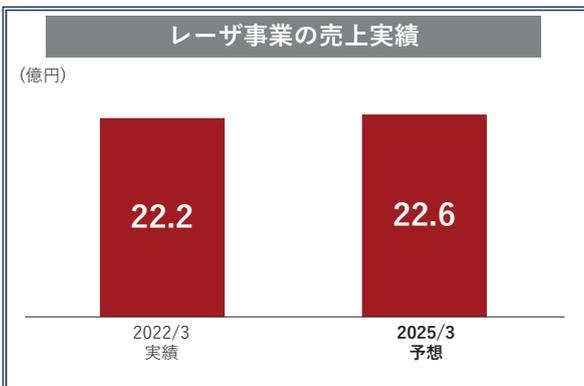
主な成果

- ・ 生産性改善に繋がるパーツやサービスの提案で、アフターサービスを高付加価値ビジネスへ転換
- ・ M&Aによりブレード事業を獲得し消耗品の取扱いを拡大
- ・ 半導体事業の拠点を活用し工具事業の海外展開を開始

※TSS：トータルソリューションサービス
(半導体製造装置の部品販売やアフターサービス、リニューアルビジネスなど)

第一次中期経営計画の振り返り（レーザ事業）

- ✓ 直販体制の推進により顧客対応を充実
- ✓ 半導体事業の販路を活用し海外顧客を開拓
- ✓ レーザプロセス技術を半導体事業へ展開



主な成果

- ・ 直販体制への移行により、きめ細かなサービスと顧客ニーズの把握が可能に
- ・ TOWAグループ拠点と連携し海外販売体制を強化
- ・ レーザプロセス技術を活用した半導体製造装置を開発

第一次中期経営計画の振り返り（サステナビリティ）



■ 脱炭素の取組み

- ▶ TOWAグループのCO2排出量削減目標を策定
- ▶ CO2排出量削減（Scope1+2）は概ね計画通り進捗（2023年度実績として2020年度比21.0%削減）
- ▶ Scope3の算定を開始

■ 人的資本経営の推進

- ▶ 人財育成制度を充実
（TOWAアカデミー準備室設置、eラーニングの充実、定年再雇用制度運用など）
- ▶ 健康経営に関する外部評価・認定の取得
（健康経営優良法人、スポーツエールカンパニー、えるぼしなど）

■ 統合報告書の発行を開始（2023年度より）

■ 英文開示の推進

- ▶ ステークホルダーに重要な情報を日英同時に発信

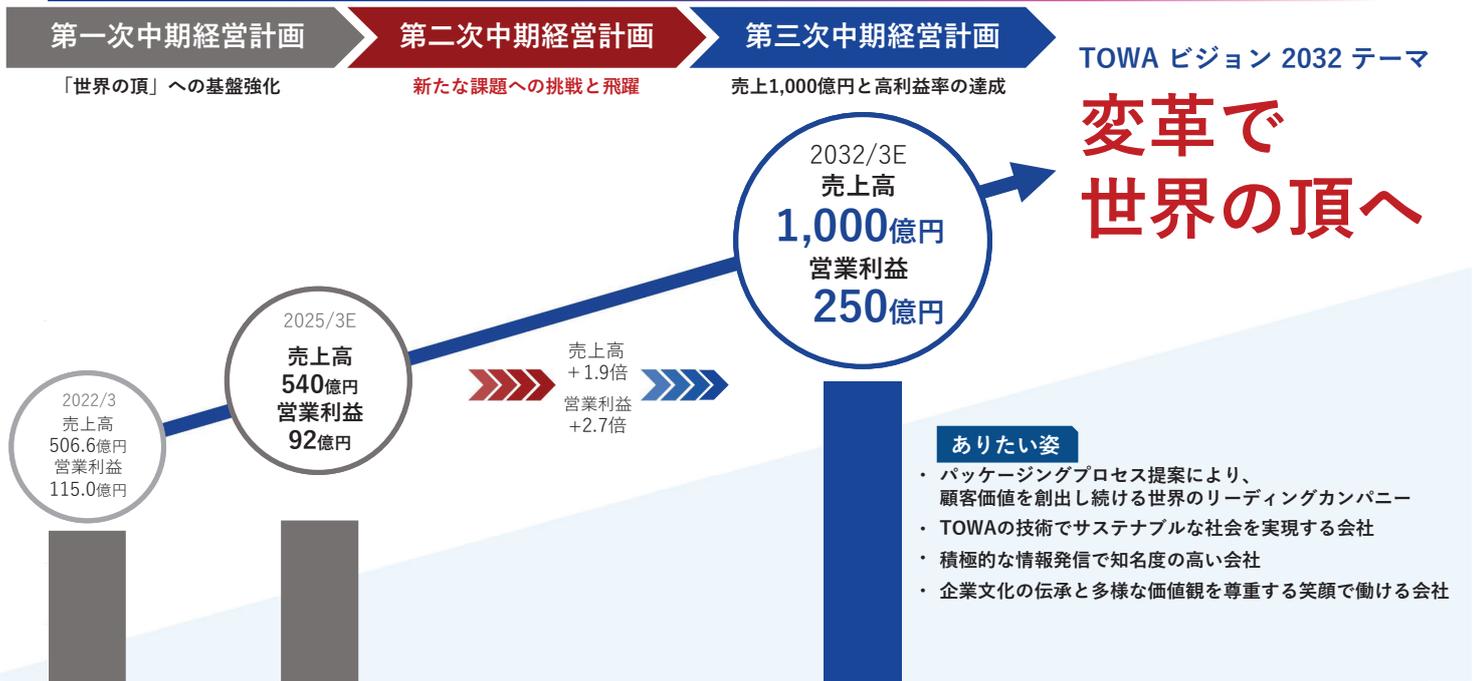
■ 役員・従業員への株式報酬制度を導入

- ▶ 譲渡制限付株式報酬制度を導入（役員・執行役員向け）
- ▶ 株式給付信託（J-ESOP）を導入（従業員向け）

主な説明内容

1. 第一次中期経営計画の振り返り
2. 第二次中期経営計画

TOWAビジョン2032



第二次中期経営計画の位置付け

第一次中期経営計画で強化した基盤により、新たな課題へ挑戦し売上高1,000億円に向けた飛躍を行う期間



第二次中期経営計画テーマ（3ヵ年）

TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出

TOWAは10年先、20年先、30年先も業界トップであり続けるため、これまで以上に積極的に人財投資を行います。

TOWA人財戦略

企業理念の継承と
技術の伝承を
TOWAアカデミーで

未来を担う
リーダーの創出

DX・AIで
人的資本の強化

多様な人財の
活躍環境の構築

第二次中期経営計画 基本方針

- ① パラダイムシフトにより製品・サービスの付加価値を向上し収益力を高める
- ② DXとAIの活用によりスピード経営を実現し市場競争力を強化する
- ③ コアコンピタンス※を活用し新たな市場を創り出す
- ④ 多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代をリードする人財の育成を図る
- ⑤ サステナビリティへの積極的な取組みにより社会貢献と企業価値の向上を図る

※他社に真似できない核となる能力。独自の強みや専門性など

第二次中期経営計画 数値目標

(単位：億円)

	2025/3期 予想	→	2028/3期	2032/3期
売上高	540.0	+31.5%	710	1,000
営業利益	92.0	+69.6%	156	250
営業利益率	17.0%	+5pt	22.0%	25.0%
経常利益	97.6	+59.8%	156	250
当期純利益	78.7	+38.5%	109	175

※ 当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

第二次中期経営計画 数値目標

「化成品事業」は「メディカルデバイス事業」へ名称変更します

(単位：億円)

	2025/3期 予想	→	2028/3期
売上高	540.0	+31.5%	710
半導体事業	399.0	+30.6%	521
メディカル デバイス事業	22.8	+22.8%	28
新事業	95.6	+39.1%	133
レーザ事業	22.6	+23.9%	28

事業戦略（半導体事業）

プロセスイノベーションで
顧客ニーズに応える

DXとAIの活用で
世界のコストリーダーへ

グローバルな開発体制で
オンリーワン製品を世界に

収益確保
に向けて

- ・コンプレッション比率アップ
- ・高付加価値製品の比率増や、AI・DX活用等により半導体事業の売上総利益率を改善

主な取組み

- ・ハイエンドパッケージング工程で絶対的なトップシェアを確立
- ・MUFやレジフローコントロールなどのオンリーワンプロセスを拡販
- ・DXやAI、ロボットによるスマートファクトリー化

半導体事業の売上目標

(億円)



事業戦略（メディカルデバイス事業）

セグメント名称変更

すぐれた成形技術を
高度な医療機器づくりに

一貫生産で高収益体制に

技能の研鑽で
価値創造ビジネスを

収益確保
に向けて

「成形技術」と「組立技術」を核に高付加価値製品の拡販と利益増大を目指す

主な取組み

- ・生産拠点の増強を見据えた生産体制の効率化とスマートファクトリー化の推進
- ・TOWAグループのコアコンピタンスとメディカルデバイス事業の技術を融合し次世代ビジネスを開拓
- ・メディカルデバイス企業としてブランドを構築

メディカルデバイス事業の売上目標

(億円)



事業戦略（新事業）

コアコンピタンスを軸に
高付加価値製品で
事業拡大を

工具メーカーとして
メジャーブランドに

サブスクビジネスで
新たな収益を築く

リニューアルビジネスで
サステナビリティを実現

収益確保 に向けて

- ・納入済み装置台数の増加と、リニューアルビジネスの推進などによる売上拡大と利益率アップ
- ・工具事業を新たな柱に

主な取組み

- ・3,500台超の納入済み装置への高付加価値なサポートを提供
- ・リニューアルビジネスの営業エリアを拡大
- ・工具事業の強化
スマートファクトリー化による生産の最適化
ラインナップの充実、グローバル販売体制の強化

新事業の売上目標

(億円)



事業戦略（レーザ事業）

競争力のある製品で
安定的な収益確保と事業拡大を

発振ユニット内製化と
サブスクビジネスへ

レーザ技術で
半導体プロセスに一石を

収益確保 に向けて

- ・競争力のある製品販売と生産コスト削減により利益率をアップ
- ・半導体プロセスに活用できるプロセス・製品を開発

主な取組み

- ・次世代半導体パッケージングの実現に有効なレーザ工法を確立する
- ・グループ連携強化による海外営業・サポート体制の拡充と生産効率化
- ・サブスクビジネスなど新たな保守サービスで付加価値を創出

レーザ事業の売上目標

(億円)



サステナビリティ戦略



TOWAグループのマテリアリティ（重要課題）

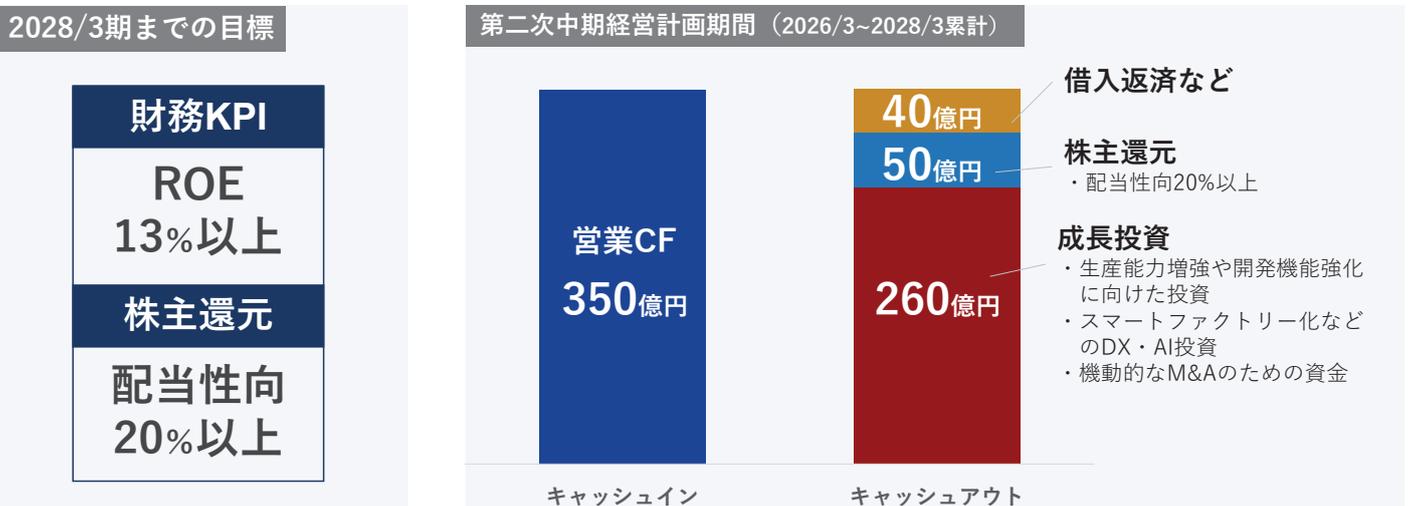


マテリアリティについての取組みは下記弊社ウェブサイトをご参照下さい。
<https://www.towajapan.co.jp/jp/company/materiality/>

上記項目をマテリアリティ（重要課題）と特定し、「TOWAビジョン2032」で明確にした10年後のありたい姿に向けて、社会への価値提供を通じて社会の持続可能性の向上を図ると同時に、企業の長期的・持続的な「稼ぐ力」の向上と更なる価値創出へとつなげてまいります。

財務戦略／キャッシュアロケーション

- ・ 営業CFの多くは成長投資に配分
- ・ 一方で資本効率改善も意識し、新たに「財務KPI」と「株主還元目標」を設定



T O W A ビ ジ ョ ン 2 0 3 2

「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上烏羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承願います。